

2024-2030年中国电子设计 自动化（EDA）软件市场深度评估与行业前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国电子设计自动化（EDA）软件市场深度评估与行业前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/412359.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

EDA（Electronic Design Automation）即电子设计自动化软件，利用EDA工具，工程师将芯片的电路设计、性能分析、设计出IC版图的整个过程交由计算机自动处理完成。EDA是进行芯片自动化设计的基础，处于集成电路设计产业的上游，是实现超大规模集成电路设计的前提。

从全球看，2020年，全球EDA行业市场规模达到115亿美元，同比增长9.52%。2020年，全球EDA市场主要由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨头占领，其中Synopsys的全球EDA市场份额最高，为32.14%；Cadence、Siemens EDA占据了23.4%和14%的全球EDA市场份额。从国内看，2020年，我国EDA行业总销售额达到66.2亿元人民币，同比增长20.0%，实现连续增长。而我国自主EDA工具企业2020年总营业收入为9.1亿元人民币，同比增长51.5%。其中在本土市场营业收入达7.6亿元人民币，同比增幅65.0%，占国内市场份额的11.4%。专利申请状况，2011-2020年中国EDA软件行业专利申请数量呈现上升态势，2020年中国EDA软件行业专利申请数量大幅上升，为261项。在专利授权数量呈现先升后降的趋势，2017年授权量达到50项，为近十年峰值，随后开始出现下降，2020年中国EDA软件行业专利授权数量为26项，授权比重仅为9.96%。2021年1-9月，中国EDA软件行业专利申请数量和专利授权数量分别为138项和10项，授权比重为7.25%。

资本市场动态方面，2020-2021年上半年，约有10家国产EDA企业完成了近20次融资，华大九天、概伦电子、广立微等三大EDA企业也在2021年先后叩响A股大门，华为旗下哈勃投资接连入股了四家厂商。作为“芯片之母”，EDA在资本市场刮起了旋风。作为“EDA第一股”，概伦电子于2021年12月28日正式登陆科创板。这对我国半导体产业而言，将是个标志性的大事。

在政策方面，2020年8月，在国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》就提及，聚焦材料、EDA、设备等探索关键核心技术攻关新型举国体制，同时探索建立软件正版化工作长效机制。2021年3月12日，国务院发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，其中提出集成电路位列7大科技前沿领域攻关的第3位，并明确指出，重点攻关集成电路设计工具（EDA）。2021年11月30日，工信部发布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，其中提出重点突破工业软件，关键基础软件补短板。建立EDA开发商、芯片设计企业、代工厂商等上下游企业联合技术攻关机制，突破针对数字、模拟及数模混合电路设计、验证、物理实现、制造测试全流程的关键技术，完善先进工艺工具包。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国电子设计自动化（EDA）软件市场深度评估与行业前景

预测报告》共十二章。首先介绍了EDA软件的定义、种类等，接着分析了EDA软件行业的发展环境、国内外EDA软件行业发展综况，然后具体介绍了EDA软件国产化的发展背景及状况、EDA软件的相关产业以及国内外重点EDA软件企业的发展状况。最后分析了中国EDA软件行业的投资状况及发展前景趋势。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心、中国半导体行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对EDA软件行业有个系统深入的了解、或者想投资EDA软件行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 电子设计自动化（EDA）软件相关概述

1.1 芯片设计基本概述

1.1.1 芯片生产流程图

1.1.2 芯片设计的地位

1.1.3 芯片设计流程图

1.2 EDA软件基本介绍

1.2.1 EDA软件基本概念

1.2.2 EDA软件主要功能

1.2.3 EDA软件的重要性

1.3 EDA软件主要类型

1.3.1 EDA常用软件

1.3.2 电路设计与仿真工具

1.3.3 PCB设计软件

1.3.4 IC设计软件

1.3.5 其它EDA软件

1.4 EDA软件的设计过程及步骤

1.4.1 EDA软件设计过程

1.4.2 EDA软件设计步骤

第二章 EDA软件行业发展环境分析

2.1 经济环境

- 2.1.1 宏观经济概况
- 2.1.2 对外经济分析
- 2.1.3 工业运行情况
- 2.1.4 固定资产投资
- 2.1.5 转型升级态势
- 2.1.6 疫后经济展望
- 2.2 政策环境
 - 2.2.1 芯片产业政策汇总
 - 2.2.2 产业投资基金支持
 - 2.2.3 税收优惠政策扶持
 - 2.2.4 地区发布补助政策
 - 2.2.5 技术限制政策动态
 - 2.2.6 科技产业发展战略
- 2.3 技术环境
 - 2.3.1 国家研发支出增长
 - 2.3.2 知识产权保护增强
 - 2.3.3 芯片技术创新升级
 - 2.3.4 芯片设计专利统计
 - 2.3.5 海外发明授权规模

第三章 产业环境——芯片设计行业全面分析

- 3.1 2021-2023年全球芯片设计行业发展综述
 - 3.1.1 市场发展规模
 - 3.1.2 区域市场格局
 - 3.1.3 市场竞争格局
 - 3.1.4 企业排名分析
- 3.2 2021-2023年中国芯片设计行业运行状况
 - 3.2.1 行业发展历程
 - 3.2.2 市场发展规模
 - 3.2.3 专利申请情况
 - 3.2.4 资本市场表现
 - 3.2.5 细分市场发展

3.3 中国芯片设计市场发展格局分析

3.3.1 企业排名状况

3.3.2 企业竞争格局

3.3.3 区域分布格局

3.3.4 产品类型分布

3.4 芯片设计具体流程剖析

3.4.1 规格制定

3.4.2 设计细节

3.4.3 逻辑设计

3.4.4 电路布局

3.4.5 光罩制作

3.5 芯片设计行业发展存在的问题和对策

3.5.1 行业发展瓶颈

3.5.2 行业发展困境

3.5.3 产业发展建议

3.5.4 产业创新策略

第四章 2021-2023年全球EDA软件行业发展分析

4.1 全球EDA市场发展综况

4.1.1 行业发展特征

4.1.2 行业发展规模

4.1.3 从业人员规模

4.1.4 细分市场格局

4.1.5 区域市场格局

4.1.6 企业竞争格局

4.1.7 企业发展要点

4.2 美国EDA市场发展布局

4.2.1 产业背景分析

4.2.2 政策支持项目

4.2.3 企业补助情况

4.2.4 企业发展布局

4.3 全球EDA软件行业发展趋势

- 4.3.1 AI融合或成重点
- 4.3.2 汽车应用需求强烈
- 4.3.3 工具和服务的云化趋势

第五章 2021-2023年中国EDA软件行业发展分析

- 5.1 EDA软件行业发展价值分析
 - 5.1.1 后摩尔时代的发展动力
 - 5.1.2 EDA是数字经济的支点
 - 5.1.3 EDA降低芯片设计成本
 - 5.1.4 加快与新型科技的融合
 - 5.1.5 推进芯片国产化的进程
- 5.2 中国EDA软件产业链分析
 - 5.2.1 产业链结构
 - 5.2.2 相关上市企业
 - 5.2.3 下游应用主体
- 5.3 中国EDA软件行业发展综况
 - 5.3.1 行业发展阶段
 - 5.3.2 企业研发历程
 - 5.3.3 市场发展规模
 - 5.3.4 市场份额占比
 - 5.3.5 市场竞争格局
- 5.4 中国EDA软件行业发展问题及对策
 - 5.4.1 产品发展问题
 - 5.4.2 人才投入问题
 - 5.4.3 市场培育问题
 - 5.4.4 工艺缺乏问题
 - 5.4.5 行业发展对策

第六章 2021-2023年EDA软件国产化发展分析

- 6.1 中国芯片国产化进程分析
 - 6.1.1 芯片国产化发展背景
 - 6.1.2 核心芯片的自给率低

- 6.1.3 芯片国产化进展分析
- 6.1.4 芯片国产化存在问题
- 6.1.5 芯片国产化未来展望
- 6.2 国产化背景——美国对中国采取科技封锁
 - 6.2.1 美国芯片封锁法规
 - 6.2.2 商业管制范围拓展
 - 6.2.3 商业管制影响领域
 - 6.2.4 EDA纳入管制清单
- 6.3 EDA软件国产化发展综况
 - 6.3.1 国内EDA软件国产化历程
 - 6.3.2 国内EDA软件国产化加快
 - 6.3.3 国产EDA软件的发展机遇
 - 6.3.4 国产EDA软件的发展要求
- 6.4 EDA软件国产化的瓶颈及对策
 - 6.4.1 国产化瓶颈分析
 - 6.4.2 国产化对策分析

第七章 2021-2023年EDA软件相关产业分析——芯片IP

- 7.1 芯片IP的基本概述
 - 7.1.1 芯片IP基本内涵
 - 7.1.2 芯片IP发展地位
 - 7.1.3 芯片IP主要类别
 - 7.1.4 芯片IP的特征优势
- 7.2 芯片IP市场发展综况
 - 7.2.1 全球市场规模
 - 7.2.2 行业发展特点
 - 7.2.3 全球竞争格局
 - 7.2.4 国内市场状况
 - 7.2.5 国内市场建议
 - 7.2.6 市场发展热点
- 7.3 芯片IP技术未来发展趋势
 - 7.3.1 技术工业融合趋势

- 7.3.2 研发遵循相关原则
- 7.3.3 新型产品研发趋势
- 7.3.4 AI算法技术推动趋势
- 7.3.5 研发应用平台化态势
- 7.3.6 开源IP设计应用趋势

第八章 EDA软件技术发展分析

- 8.1 EDA软件技术发展历程
 - 8.1.1 计算机辅助阶段（CAD）
 - 8.1.2 计算机辅助工程阶段（CAE）
 - 8.1.3 电子设计自动化阶段（EDA）
- 8.2 EDA软件技术标准分析
 - 8.2.1 EDA设计平台标准
 - 8.2.2 硬件描述语言及接口标准
 - 8.2.3 EDA系统框架结构
 - 8.2.4 IP核标准化
- 8.3 EDA软件技术的主要内容
 - 8.3.1 大规模可编程逻辑器件（PLD）
 - 8.3.2 硬件描述语言（HDL）
 - 8.3.3 软件开发工具
 - 8.3.4 实验开发系统
 - 8.3.5 EDA技术的应用
- 8.4 EDA技术主要应用领域
 - 8.4.1 科研应用方面
 - 8.4.2 教学应用方面
- 8.5 EDA技术应用于电子线路设计
 - 8.5.1 技术实现方式
 - 8.5.2 技术实际应用
 - 8.5.3 技术应用要求
- 8.6 智能技术与EDA技术融合发展
 - 8.6.1 技术融合发展背景
 - 1.1.1 技术融合发展优势

- 8.6.2 技术研发布局加快
- 8.6.3 融合技术应用分析
- 1.1.1 技术融合发展问题
- 8.6.4 技术融合发展展望
- 8.6.5 技术融合发展方向
- 8.7 EDA软件技术发展壁垒
- 8.7.1 需要各环节协同合作
- 8.7.2 需要大量的理论支撑
- 8.7.3 需要大量综合性人才

第九章 2021-2023年全球主要EDA软件企业发展分析

- 9.1 Synopsys
 - 9.1.1 企业基本概况
 - 9.1.2 企业布局动态
 - 9.1.3 商业模式创新
 - 9.1.4 财务运营状况
 - 9.1.5 研发投入状况
 - 9.1.6 企业收购情况
- 9.2 Cadence
 - 9.2.1 企业基本概况
 - 9.2.2 产品范围分析
 - 9.2.3 商业模式创新
 - 9.2.4 财务运营状况
 - 9.2.5 研发投入状况
 - 9.2.6 企业收购情况
- 9.3 Mentor Graphics
 - 9.3.1 企业发展概况
 - 9.3.2 主要产品概述
 - 9.3.3 财务运营状况
 - 9.3.4 企业收购情况
- 9.4 三大企业的发展比较分析
 - 9.4.1 发展优势比较

- 9.4.2 产品服务对比
- 9.4.3 主要客户对比
- 9.4.4 中国市场布局

第十章 2021-2023年中国EDA软件企业发展分析

10.1 华大九天

- 10.1.1 企业发展概况
- 10.1.2 业务布局领域
- 10.1.3 客户覆盖范围
- 10.1.4 企业发展成果
- 10.1.5 企业融资情况
- 10.1.6 企业发展战略

10.2 芯禾科技

- 10.2.1 企业发展概况
- 10.2.2 主要产品分析
- 10.2.3 企业融资布局
- 10.2.4 企业发展动态

10.3 广立微电子

- 10.3.1 企业发展概况
- 10.3.2 产品服务领域
- 10.3.3 重点产品概述
- 10.3.4 市场覆盖范围

10.4 概伦电子

- 10.4.1 企业发展概况
- 10.4.2 主要产品分析
- 10.4.3 企业融资动态

10.5 芯愿景

- 10.5.1 企业发展概况
- 10.5.2 主营业务分析
- 10.5.3 主要经营模式
- 10.5.4 财务运营状况
- 10.5.5 竞争优势分析

- 10.5.6 主要技术分析
- 10.5.7 未来发展战略
- 10.6 其他相关企业
- 10.6.1 博达微科技
- 10.6.2 天津蓝海微科技
- 10.6.3 成都奥卡思微电科技
- 10.6.4 智原科技股份有限公司

第十一章 2021-2023年中国EDA软件行业投资分析

- 11.1 EDA软件行业投资机遇
 - 11.1.1 技术创新发展机遇
 - 11.1.2 人才供给改善机遇
 - 11.1.3 资本环境改善机遇
- 11.2 EDA软件行业融资加快
 - 11.2.1 大基金融资动态
 - 11.2.2 科创板融资动态
- 11.3 EDA软件项目投资动态
 - 11.3.1 中科院青岛EDA中心项目
 - 11.3.2 国微深圳EDA开发项目
 - 11.3.3 集成电路设计创新中心项目
 - 11.3.4 芯禾电子完成C轮项目融资
 - 11.3.5 概伦电子获得A轮项目融资
 - 11.3.6 立芯华章EDA创新中心项目
 - 11.3.7 合肥市集成电路服务平台项目
- 11.4 EDA软件行业投资风险
 - 11.4.1 技术风险分析
 - 11.4.2 人员流失风险
 - 11.4.3 贸易摩擦风险
 - 11.4.4 市场竞争风险
 - 11.4.5 法律风险分析
- 11.5 EDA软件行业投资要点
 - 11.5.1 紧紧围绕发展驱动因素

- 11.5.2 强抓产业发展的核心
- 11.5.3 建立具备复合经验团队
- 11.5.4 加深产业投资规律理解

第十二章 2024-2030年EDA软件行业发展前景预测分析

- 12.1 中国芯片设计行业发展前景
 - 12.1.1 技术创新发展
 - 12.1.2 市场需求状况
 - 12.1.3 行业发展前景
- 12.2 中国EDA软件行业发展前景
 - 12.2.1 整体发展机遇
 - 12.2.2 整体发展前景
 - 12.2.3 国内发展机会
 - 12.2.4 国产化发展要点
- 12.3 对2024-2030年中国EDA软件行业预测分析
 - 12.3.1 对中国EDA软件行业的影响因素分析
 - 12.3.2 对2024-2030年EDA软件行业规模预测

图表目录

- 图表 芯片生产历程
- 图表 IC产业链
- 图表 芯片设计和生产流程图
- 图表 EDA软件处于半导体产业链的上游环节
- 图表 2017-2021年国内生产总值及其增长速度
- 图表 2017-2021年全国三次产业增加值占国内生产总值比重
- 图表 2017-2021年货物进出口总额
- 图表 2021年货物进出口总额及其增长速度
- 图表 2021年主要商品出口数量、金额及其增长速度
- 图表 2021年主要商品进口数量、金额及其增长速度
- 图表 2021年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
- 图表 2017-2021年全部工业增加值及其增长速度
- 图表 2021年主要工业产品产量及其增长速度

图表 2021-2022年规模以上工业增加值同比增长速度

图表 2022年规模以上工业生产主要数据

图表 2021年三次产业投资占固定资产投资

图表 2021年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表 2021年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表 2021-2022年固定资产投资（不含农户）同比增速

图表 2022年固定资产（不含农户）主要数据

图表 中国芯片产业相关政策汇总（一）

图表 中国芯片产业相关政策汇总（二）

图表 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标

图表 一期大基金投资各领域份额占比

图表 一期大基金投资领域及部分企业

图表 EDA产业限制政策梳理

图表 研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度

图表 专利申请、授权和有效专利情况

图表 集成电路布图设计专利统计

图表 国内半导体上市公司的海外发明授权量TOP10

图表 全球IC设计业销售额

图表 全球IC设计行业区域分布

图表 全球前十大IC设计公司排名

图表 IC设计的不同阶段

图表 中国IC设计行业销售额及增长率

图表 集成电路布图设计专利申请及发证数量

图表 中国十大芯片设计企业

图表 中国IC设计公司数量

图表 全国主要城市IC设计业规模

图表 芯片设计流程图

图表 芯片设计流程

图表 32bits加法器的Verilog范例

图表 光罩制作示意图

图表 全球EDA软件主要特征

图表 全球EDA软件行业市场规模统计情况

图表 全球EDA市场从业情况

图表 Cadence部分高校合作项目

图表 全球EDA软件行业细分领域市场份额统计情况

图表 全球EDA软件行业区域市场份额统计情况

图表 全球EDA三巨头基本情况

图表 全球EDA软件行业市场竞争格局分析情况

图表 美国半导体公司依靠高利润-高研发投入形成正向循环

图表 全球主要半导体领域全球的市场份额概览

图表 DARPA公布的ERI六大项目

图表 DARPA对Cadence与Synopsys的补助情况

图表 Cadence提供的云服务

图表 Virtuoso平台智能框架

图表 EDA成为后摩尔时代的产业发展动力

图表 芯片/集成电路产业倒金字塔

图表 SoC芯片的流片成本不制程的关系

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/412359.html>